

# 2023-2029年中国半导体封装设备行业研究与前景趋势报告

## 报告目录及图表目录

中国产业研究报告网 编制

[www.chinairr.org](http://www.chinairr.org)

## 一、报告报价

《2023-2029年中国半导体封装设备行业研究与前景趋势报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.chinairr.org/report/R06/R0601/202307/25-536821.html>

产品价格：纸介版9800元 电子版9800元 纸介+电子10000元

订购电话: 400-600-8596 010-80993936

传真: 010-60343813

网址: <http://www.chinairr.org>

Email: [sales@chyxx.com](mailto:sales@chyxx.com)

联系人：刘老师 陈老师 谭老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

产业研究报告网发布的《2023-2029年中国半导体封装设备行业研究与前景趋势报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业布局煤炭综采设备后市场服务行业的重要决策参考依据。

报告目录：

### 第1章：半导体封装设备行业界定及发展环境剖析

#### 1.1 半导体封装设备行业界定及统计说明

##### 1.1.1 半导体封装设备在半导体产业链中的地位

##### 1.1.2 半导体封装设备的界定与工作原理

###### （1）半导体封装的界定

###### （2）半导体封装设备工作原理

###### （3）半导体封装设备的分类

##### 1.1.3 本行业关联国民经济行业分类

##### 1.1.4 本报告行业研究范围的界定说明

##### 1.1.5 本报告的数据来源及统计标准说明

#### 1.2 中国半导体封装设备行业技术环境

##### 1.2.1 半导体封装技术分析

##### 1.2.2 半导体封装设备技术创新动态

##### 1.2.3 半导体封装设备相关专利申请及公开情况

##### 1.2.4 半导体封装设备技术创新趋势

##### 1.2.5 技术环境对行业发展的影响分析

#### 1.3 中国半导体封装设备行业政策环境

##### 1.3.1 行业监管体系及机构介绍

##### 1.3.2 行业标准体系建设现状

###### （1）标准体系建设

###### （2）现行标准汇总

###### （3）即将实施标准

###### （4）重点标准解读

##### 1.3.3 行业发展相关政策规划汇总及解读

- (1) 行业发展相关政策汇总
- (2) 行业发展相关规划汇总
- 1.3.4 行业重点政策规划解读
- 1.3.5 政策环境对行业发展的影响分析
- 1.4 中国半导体封装设备行业经济环境
  - 1.4.1 宏观经济发展现状
  - 1.4.2 宏观经济发展展望
  - 1.4.3 行业发展与宏观经济相关性分析
- 1.5 中国半导体封装设备行业社会环境
  - 1.5.1 中国人口规模及结构
  - 1.5.2 中国城镇化水平变化
  - 1.5.3 中国居民收入水平及结构
  - 1.5.4 中国居民消费支出水平及结构演变
  - 1.5.5 中国消费新趋势
  - 1.5.6 社会环境变化对行业发展的影响分析

## 第2章：全球半导体封装设备行业发展趋势及前景预测

- 2.1 全球半导体封装设备行业发展历程及发展环境分析
  - 2.1.1 全球半导体封装设备行业发展历程
  - 2.1.2 全球半导体封装设备行业发展环境
- 2.2 全球半导体封装设备行业供需状况及市场规模测算
  - 2.2.1 全球半导体封装设备行业供需状况
  - 2.2.2 全球半导体封装设备行业市场规模测算
- 2.3 全球半导体封装设备行业区域发展格局及重点区域市场研究
  - 2.3.1 全球半导体封装设备行业区域发展格局
  - 2.3.2 重点区域半导体封装设备行业发展分析
    - (1) 韩国
    - (2) 美国
    - (3) 日本
- 2.4 全球半导体封装设备行业市场竞争状况分析
  - 2.4.1 全球半导体封装设备行业市场竞争状况
  - 2.4.2 全球半导体封装设备企业兼并重组状况

## 2.5 全球半导体封装设备行业发展趋势及市场前景预测

### 2.5.1 全球半导体封装设备行业发展趋势预判

### 2.5.2 全球半导体封装设备行业市场前景预测

## 第3章：中国半导体封装设备行业发展现状与市场痛点分析

### 3.1 中国半导体封装设备行业发展历程及市场特征

#### 3.1.1 中国半导体封装设备行业发展历程

#### 3.1.2 中国半导体封装设备市场发展特征

### 3.2 中国半导体封装设备行业进出口状况分析

#### 3.2.1 中国半导体封装设备行业进出口概况

#### 3.2.2 中国半导体封装设备行业进口状况

##### (1) 行业进口规模

##### (2) 行业进口价格水平

##### (3) 行业进口产品结构

##### (4) 行业主要进口来源地

##### (5) 行业进口趋势及前景

#### 3.2.3 中国半导体封装设备行业出口状况

##### (1) 行业出口规模

##### (2) 行业出口价格水平

##### (3) 行业出口产品结构

##### (4) 行业主要出口来源地

##### (5) 行业出口趋势及前景

### 3.3 中国半导体封装设备行业市场供需状况

#### 3.3.1 中国半导体封装设备行业参与者类型及规模

#### 3.3.2 中国半导体封装设备行业参与者进场方式

#### 3.3.3 中国半导体封装设备行业市场供给分析

#### 3.3.4 中国半导体封装设备行业市场需求分析

#### 3.3.5 中国半导体封装设备行业价格水平及走势

### 3.4 中国半导体封装设备行业市场规模测算

### 3.5 中国半导体封装设备行业市场痛点分析

## 第4章：中国半导体封装设备行业竞争状态及市场格局分析

- 4.1 中国半导体封装设备行业市场进入与退出壁垒
- 4.2 中国半导体封装设备行业投融资、兼并与重组状况
  - 4.2.1 中国半导体封装设备行业投融资发展状况
  - 4.2.2 中国半导体封装设备行业兼并与重组状况
- 4.3 中国半导体封装设备行业市场格局及集中度分析
  - 4.3.1 中国半导体封装设备行业市场竞争格局
  - 4.3.2 中国半导体封装设备行业国际竞争力分析
  - 4.3.3 中国半导体封装设备行业国产化发展现状
  - 4.3.4 中国半导体封装设备行业市场集中度分析
- 4.4 中国半导体封装设备行业波特五力模型分析
  - 4.4.1 上游议价能力分析
  - 4.4.2 下游议价能力分析
  - 4.4.3 行业内企业竞争分析
  - 4.4.4 替代品威胁分析
  - 4.4.5 潜在进入者分析
  - 4.4.6 行业市场竞争总结

## 第5章：中国半导体封装设备产业链梳理及全景深度解析

- 5.1 半导体封装设备产业链梳理及成本结构分析
  - 5.1.1 半导体封装设备产业链结构及生态体系
  - 5.1.2 半导体封装设备的组成结构
  - 5.1.3 半导体封装设备成本结构
- 5.2 中国半导体封装设备行业上游供应市场解析
  - 5.2.1 半导体封装设备行业上游原材料类型
  - 5.2.2 半导体封装设备上游核心组件类型
  - 5.2.3 半导体封装设备上游供应状况分析
  - 5.2.4 上游供应对半导体封装设备行业发展的影响分析
- 5.3 半导体封装设备行业设计市场
- 5.4 半导体封装设备行业中游细分产品市场分析
  - 5.4.1 贴片机
  - 5.4.2 划片机
  - 5.4.3 引线焊接设备

#### 5.4.4 电镀设备

#### 5.4.5 塑封/切筋成型设备

### 5.5 半导体制造领域对半导体封装设备的需求分析

## 第6章：全球及中国半导体封装设备代表性企业发展布局案例研究

### 6.1 中国半导体封装设备代表性企业发展布局对比

### 6.2 全球半导体封装设备行业代表性企业布局案例

#### 6.2.1 日本Hitachi High-Technologies（日立高新）

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业半导体封装设备业务布局现状
- (4) 企业半导体封装设备业务投融资状况

#### 6.2.2 荷兰ASM International（先域）

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业半导体封装设备业务布局现状
- (4) 企业半导体封装设备业务投融资状况

#### 6.2.3 库力索法半导体Kulicke & Soffa(“K&S”)

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业半导体封装设备业务布局现状
- (4) 企业半导体封装设备业务投融资状况

#### 6.2.4 日本新川shinkawa

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业半导体封装设备业务布局现状
- (4) 企业半导体封装设备业务投融资状况

#### 6.2.5 荷兰BE Semiconductor Industries N.V.(Besi)

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业半导体封装设备业务布局现状
- (4) 企业半导体封装设备业务投融资状况

## 6.3 中国半导体封装设备代表性企业发展布局案例

### 6.3.1 北京艾科瑞斯科技有限公司

#### (1) 企业发展历程及基本信息

- 1) 发展历程
- 2) 基本信息
- 3) 股权结构

#### (2) 企业发展状况

- 1) 经营状况
- 2) 业务架构
- 3) 销售网络

#### (3) 企业半导体封装设备布局状况

- 1) 企业半导体封装设备布局介绍
- 2) 企业半导体封装设备发展状况
- 3) 企业半导体封装设备的研发投入/产品和技术创新/资质能力及专利获得等
- 4) 企业半导体封装设备的并购及投融资动态
- 5) 企业半导体封装设备的最新布局动态

#### (4) 企业半导体封装设备布局的优劣势分析

### 6.3.2 大连佳峰自动化股份有限公司

#### (1) 企业发展历程及基本信息

- 1) 发展历程
- 2) 基本信息
- 3) 股权结构

#### (2) 企业发展状况

- 1) 经营状况
- 2) 业务架构
- 3) 销售网络

#### (3) 企业半导体封装设备布局状况

- 1) 企业半导体封装设备布局介绍
- 2) 企业半导体封装设备发展状况
- 3) 企业半导体封装设备的研发投入/产品和技术创新/资质能力及专利获得等
- 4) 企业半导体封装设备的并购及投融资动态
- 5) 企业半导体封装设备的最新布局动态



#### (4) 企业半导体封装设备布局的优劣势分析

### 6.3.3 深圳市易天自动化设备股份有限公司

#### (1) 企业发展历程及基本信息

##### 1) 发展历程

##### 2) 基本信息

##### 3) 股权结构

#### (2) 企业发展状况

##### 1) 经营状况

##### 2) 业务架构

##### 3) 销售网络

#### (3) 企业半导体封装设备布局状况

##### 1) 企业半导体封装设备布局介绍

##### 2) 企业半导体封装设备发展状况

##### 3) 企业半导体封装设备的研发投入/产品和技术创新/资质能力及专利获得等

##### 4) 企业半导体封装设备的并购及投融资动态

##### 5) 企业半导体封装设备的最新布局动态

#### (4) 企业半导体封装设备布局的优劣势分析

### 6.3.4 深圳市溢旭电子有限公司

#### (1) 企业发展历程及基本信息

##### 1) 发展历程

##### 2) 基本信息

##### 3) 股权结构

#### (2) 企业发展状况

##### 1) 经营状况

##### 2) 业务架构

##### 3) 销售网络

#### (3) 企业半导体封装设备布局状况

##### 1) 企业半导体封装设备布局介绍

##### 2) 企业半导体封装设备发展状况

##### 3) 企业半导体封装设备的研发投入/产品和技术创新/资质能力及专利获得等

##### 4) 企业半导体封装设备的并购及投融资动态

##### 5) 企业半导体封装设备的最新布局动态

#### (4) 企业半导体封装设备布局的优劣势分析

### 6.3.5 广东木几智能装备有限公司

#### (1) 企业发展历程及基本信息

##### 1) 发展历程

##### 2) 基本信息

##### 3) 股权结构

#### (2) 企业发展状况

##### 1) 经营状况

##### 2) 业务架构

##### 3) 销售网络

#### (3) 企业半导体封装设备布局状况

##### 1) 企业半导体封装设备布局介绍

##### 2) 企业半导体封装设备发展状况

##### 3) 企业半导体封装设备的研发投入/产品和技术创新/资质能力及专利获得等

##### 4) 企业半导体封装设备的并购及投融资动态

##### 5) 企业半导体封装设备的最新布局动态

#### (4) 企业半导体封装设备布局的优劣势分析

### 6.3.6 北京中科同志科技股份有限公司

#### (1) 企业发展历程及基本信息

##### 1) 发展历程

##### 2) 基本信息

##### 3) 股权结构

#### (2) 企业发展状况

##### 1) 经营状况

##### 2) 业务架构

##### 3) 销售网络

#### (3) 企业半导体封装设备布局状况

##### 1) 企业半导体封装设备布局介绍

##### 2) 企业半导体封装设备发展状况

##### 3) 企业半导体封装设备的研发投入/产品和技术创新/资质能力及专利获得等

##### 4) 企业半导体封装设备的并购及投融资动态

##### 5) 企业半导体封装设备的最新布局动态

#### (4) 企业半导体封装设备布局的优劣势分析

### 6.3.7 巨力精密设备制造（东莞）有限公司

#### (1) 企业发展历程及基本信息

##### 1) 发展历程

##### 2) 基本信息

##### 3) 股权结构

#### (2) 企业发展状况

##### 1) 经营状况

##### 2) 业务架构

##### 3) 销售网络

#### (3) 企业半导体封装设备布局状况

##### 1) 企业半导体封装设备布局介绍

##### 2) 企业半导体封装设备发展状况

##### 3) 企业半导体封装设备的研发投入/产品和技术创新/资质能力及专利获得等

##### 4) 企业半导体封装设备的并购及投融资动态

##### 5) 企业半导体封装设备的最新布局动态

#### (4) 企业半导体封装设备布局的优劣势分析

## 第7章：中国半导体封装设备行业市场及投资策略建议

### 7.1 中国半导体封装设备行业发展潜力评估

#### 7.1.1 行业发展现状总结

#### 7.1.2 行业影响因素总结

#### 7.1.3 行业发展潜力评估

##### (1) 行业生命发展周期

##### (2) 行业发展潜力评估

### 7.2 中国半导体封装设备行业发展前景预测

### 7.3 中国半导体封装设备行业发展趋势预判

### 7.4 中国半导体封装设备行业投资风险预警与防范策略

#### 7.4.1 中国半导体封装设备行业投资风险预警

#### 7.4.2 中国半导体封装设备投资风险防范策略

### 7.5 中国半导体封装设备行业投资价值评估

### 7.6 中国半导体封装设备行业投资机会分析

## 7.7 中国半导体封装设备行业投资策略与建议

## 7.8 中国半导体封装设备行业可持续发展建议

### 图表目录

图表1：半导体封装设备在半导体工艺流程中的位置

图表2：半导体封装设备工作原理

图表3：半导体封装设备分类及说明

图表4：《国民经济行业分类（GB/T 4754-2021年）》中半导体封装设备行业所归属类别

图表5：本报告半导体封装设备行业研究范围界定

图表6：本报告的主要数据来源及统计标准说明

图表7：截至2021年半导体封装设备行业标准汇总

图表8：截至2021年半导体封装设备行业发展政策汇总

图表9：截至2021年半导体封装设备行业发展规划汇总

图表10：2012-2021年中国大陆人口数量情况（单位：亿人）

图表11：2011-2021年我国城乡人口比重情况（单位：%）

图表12：2014-2021年中国居民人均消费支出（单位：元）

图表13：2014-2021年中国居民消费结构情况（单位：元）

图表14：中国消费升级演进趋势

图表15：全球半导体封装设备行业区域发展格局（单位：%）

图表16：全球半导体封装设备行业发展趋势预判

图表17：2022-2027年半导体封装设备行业市场前景预测

图表18：中国半导体封装设备行业市场发展痛点分析

图表19：中国半导体封装设备行业市场进入与退出壁垒分析

图表20：行业并购特征分析

图表21：行业兼并重组意图

图表22：我国半导体封装设备行业上游的议价能力分析

图表23：我国半导体封装设备行业下游客户议价能力分析

图表24：我国半导体封装设备行业现有企业的竞争分析

图表25：我国半导体封装设备行业潜在进入者威胁分析

图表26：中国半导体封装设备行业市场竞争强度总结

图表27：半导体封装设备产业链结构

图表28：半导体封装设备产业链生态图谱

图表29：上游供应对半导体封装设备行业发展的影响分析

图表30：中国半导体封装设备产业链代表性企业发展布局对比

图表31：北京艾科瑞斯科技有限公司发展历程

图表32：北京艾科瑞斯科技有限公司基本信息表

图表33：北京艾科瑞斯科技有限公司股权穿透图

图表34：北京艾科瑞斯科技有限公司经营状况

图表35：北京艾科瑞斯科技有限公司整体业务架构

详细请访问：<http://www.chinairr.org/report/R06/R0601/202307/25-536821.html>